

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

有研粉末新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表（2024年12月27日）

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	民生证券、泰康资产
会议时间	2024年12月27日 11:00-12:00
会议地点	有研大厦
上市公司接待人员	董事会秘书、财务总监、总法律顾问：姜珊 证券事务代表：王妍 证券事务专员：瓮佳星
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：请简要介绍公司今年的整体经营情况。</p> <p>A1：公司前三季度整体销量 23,000 吨，同比增长 10%，营业收入 23 亿元，同比增长 18%，其中销量增长带来的增量是 11%，由于原材料价格上涨带来的增量是 7%。利润总额 4,489 万元，同比增长 3%。四季度市场开拓效果良好，11 月公司铜粉销量再创新高，有研合肥、有研重冶、英国 Makin 公司均创造了本公司有史以来单月销量的最高记录。3D 打印板块和电子浆料板块在今年也会有比较大的提升。</p> <p>Q2：原材料波动对利润影响如何。</p> <p>A2：公司铜基板块和锡基板块定价模式主要为原材料+加工费，原材料价格上涨会造成收入上升，加工费不变的情况下，会降低产品毛利率。目前公司采用套期保值方式来对冲原材料波动的风险。</p> <p>Q3：铜基板块的下游应用都有哪些领域。</p>

A3: 铜基金属粉体材料应用范围很广，如粉末冶金、金刚石工具、摩擦材料、催化剂、电碳电刷、散热器件等下游领域，其中金刚石工具受房地产和基建市场低迷的影响占比有所下降，同时粉末冶金、高铁刹车片以及用于导电、散热用途的铜粉占比有所提高。

Q4: 铜粉在散热器件这部分的应用如何？

A4: 铜基板块目前实现突破的新产品主要为导热铜粉，主要用于制造风冷散热组件，现已成功应用于部分 GPU 散热器件。据了解该产品目前也已部分应用于 AI 算力服务器、基站、大型路由器、交换机等场景，应用效果截至目前反馈良好。

Q5: 散热铜粉和传统铜粉有什么区别？

A5: 传统铜粉用的是雾化法，散热铜粉是化学法。与传统雾化铜粉相比，散热铜粉具有梯度孔隙结构、比表面积发达、松装密度低等特点。此款铜粉在散热效率方面较传统雾化铜粉，性能提升 10%-20%，热端收益 3-5℃，属于行业内比较大的进步。

Q6: 国内还有哪些厂商能供应散热铜粉？该产品的技术壁垒是什么？

A6: 新型散热铜粉截至目前是有研合肥独家生产。公司经过多年发展，在长期研发积累的大量实验数据、工艺经验基础上，形成了完善的研发技术体系，拥有国家级创新平台，材料研发团队可以参与到客户的设计端，共同设计、开发需要的粉体材料，定制适合于下游客户应用的粉体产品。本次散热铜粉研发起源于下游客户的应用需求，经双方合作研发两年研制成功，在加工方式上实现了突破，解决了以新的生产方式制造的散热铜粉在产品应用上的问题，现已实现稳定的吨级供货，在行业内属于首创。

Q7: 铜粉未来有什么新产品吗？

A7: 公司目前铜基板块国内市场占有率第一，未来粉体制造的主要目标是高纯、超细、超低松比，通过提高产品附加值，向新的应用领域拓展、延伸。除了新研发的导热铜粉，公司也一直致力于复合铜粉、超细铜粉、电子级氧化铜粉、铁铜预合金粉、低松比铜粉等高附加值产品的研发。

Q8: 电子级氧化铜粉目前在 PCB 里应用如何？

A8: 公司一直在研发电子级氧化铜粉，今年进行了生产线的建设，同时与客户建立了可靠联系。明年会有大的扩产

项目，预计共有 1500 吨的氧化铜粉，这部分能给公司带来新的利润增长点。电子级氧化铜粉较之传统铜粉的优势，在于可以用电子铜粉用过的残板进行加工，这样可压缩成本，获得更高的收益。预估明后年这部分会有较大的增长。

Q9：英国公司今年整体情况如何？

A9：公司于 2013 年收购的英国 Makin 公司，其技术实力强，自动化程度高，自收购以来整体经营情况不错，该公司 2023 年度利润不高是因为其销售以欧洲市场为主，2023 年欧洲市场整体低迷，同时部分能源价格大幅增长、汇兑损失增加，导致成本费用增加、利润减少。2024 年以来，英国 Makin 公司市场需求逐步恢复，美国市场复苏，经营业绩持续向好，前三季度利润同比增长 10 倍，预计明年也会有所增长。

Q10：锡粉板块今年利润下降是什么原因？

A10：公司锡基板块产品主要用于微电子封装。今年业绩下降是由于锡基板块子公司康普锡威的两个美资客户开始实现自供粉，因此这部分销量下滑。但是本年锡基板块也实现了新的突破：一是锡粉在军工用途上实现了新突破，比如锡球、锡柱；二是康普锡威公司通过了全球知名认证公司 UL Solutions 严格的资料及生产现场审核，喜获 UL 2809 标准的再生含量验证证书，这也是国内锡焊粉行业首张 UL 2809 验证证书。目前市场新客户的开拓情况良好，预计明年能有不错的表现。

Q11：3D 打印产品在公司内部的产品结构如何？

A11：公司 3D 打印板块产品基本构成是 40%铝合金粉，包括铝硅十镁、铝硅七镁；20%高温合金粉；40%其他粉末，包括钛合金粉、铜合金粉、不锈钢粉等。

Q12：3D 打印粉体材料在今年有比较明显的加速，公司 3D 打印产能如何？

A12：目前公司 3D 打印产能约 500 吨，但是随着市场需求增长，应用端持续放量，公司订单量增速较快，目前的产能开始受限，计划明年扩产。

Q13：公司机器人研发合作项目进展如何？

A13：公司前期以研发为主，承接了关于机器人项目的研发课题，如北京市科技计划项目高精密谐波减速器设计与制造关键技术研究项目，主要应用于小型机器人。该产品的主要原材料为铁基粉末，采用粉末冶金工艺制作，应用

	<p>于机器人关节部位。现有上市公司与公司联系定制化相关零件，双方正处于洽谈阶段。</p> <p>Q14: 公司未来三年的发展目标。 Q14: 公司未来以创新引领发展，以新产业为主导，夯实锡粉、铜粉主业，提高销量、把握机遇，重点发展 3D 打印板块和电子浆料板块，目前 3D 打印行业虽然进入者很多，竞争非常激烈，但我们分析仍出于行业爆发前期，行业容量大，每年约有 25%左右的增速。公司之前的发展主要聚焦于粉体材料本身，未来会不断摸索适合 3D 打印发展的最优模式。为此公司已经开始布局，公司依托科创中心的募投项目，对 3D 打印板块进行投入，建立实验室，增加对粉体材料的验证环节，缩短客户的验证周期，预计到 2025 年底完成建设。同时，在提高 3D 打印粉末制备能力上持续加劲，计划通过建立新基地，实现规模生产。电子浆料板块还处于技术研发阶段，主要聚焦国家任务，属于未来产业。公司之后将继续融入国家战略，保障产业链供应链安全稳定，加快传统产业转型，打造战略性新兴产业，在中国式现代化建设中展现央企责任担当，以更加优异的业绩回报广大投资者。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2024 年 12 月 30 日</p>